



高压大功率白光 LED



2GF38A5050

产品概述

2GF38A5050是采用电压55V的高压蓝光 HV LED 芯片和 SMD5050 支架进行封装的白光灯珠。

特征参数

符号	典型值	单位
V_F	55	V
I_F	20	mA
Φ_V	95	lm
P	1.1	W

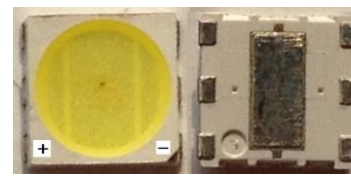
产品特点

- 高压小电流应用
- 17 个单元晶粒内部互联方式串联
- 可靠性高

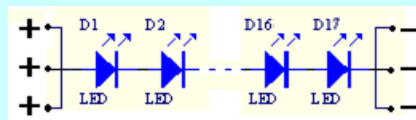
应用

- 球泡灯
- 筒灯
- 射灯
- 蜡烛灯

封装 SMD5050



内部结构图



极限值

除非另有规定, $T_a=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位
正向电流(DC)	I_F	20	mA
最大直流阻断电压	V_R	80	V
工作结温	T_j	-30~85	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	-40~100	$^{\circ}\text{C}$

电参数

除非另有规定, $T_a=25^{\circ}\text{C}$

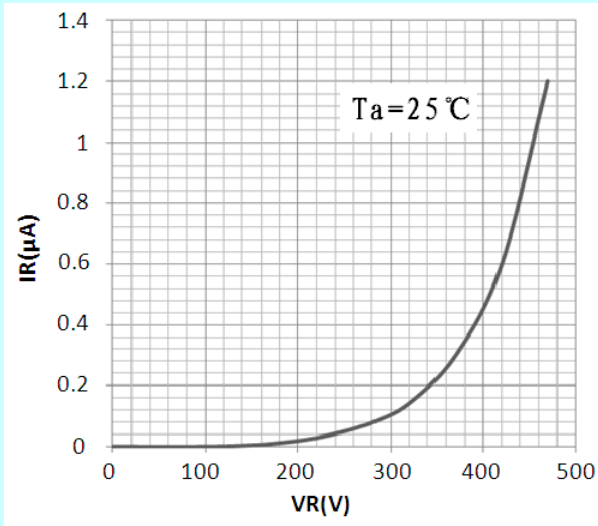
参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
光通量	Φ_V	$I_F=20\text{mA}$	90	95		lm
色温	CT	$I_F=20\text{mA}$		6500		k
显色指数	Ra	$I_F=20\text{mA}$	68	72		
正向压降	V_F	$I_F=20\text{mA}$	50	55	60	V
总功率	P	$I_F=20\text{mA}$		1.1		W

有害物质说明

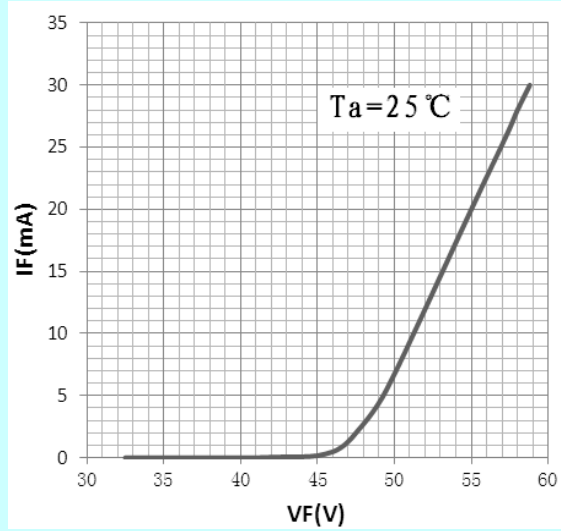
部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE	六溴环 十二烷 HBCDD	邻苯二 甲酸酯 DEHP	邻苯二甲 酸二丁酯 DBP	邻苯二甲 酸丁苄酯 BBP
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
支架	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
硅胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
固晶胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	<p>○: 表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。</p> <p>×: 表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。</p> <p>目前产品的焊料中含有铅 (Pb) 成分, 但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。</p>									

特性曲线

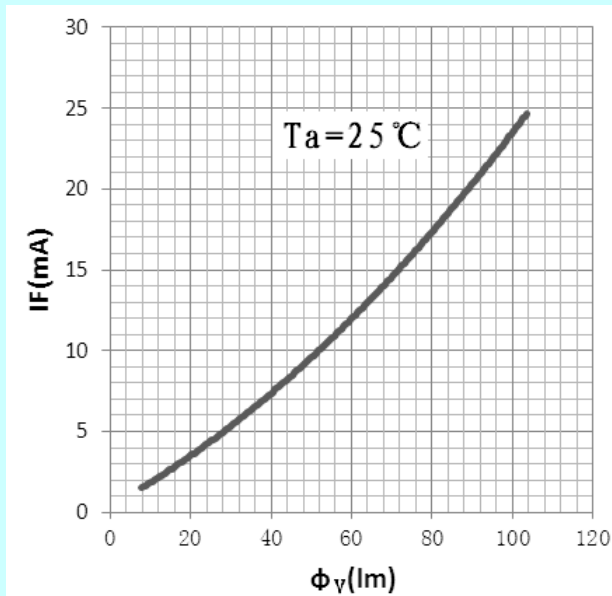
图(1) I_R-V_R 关系曲线



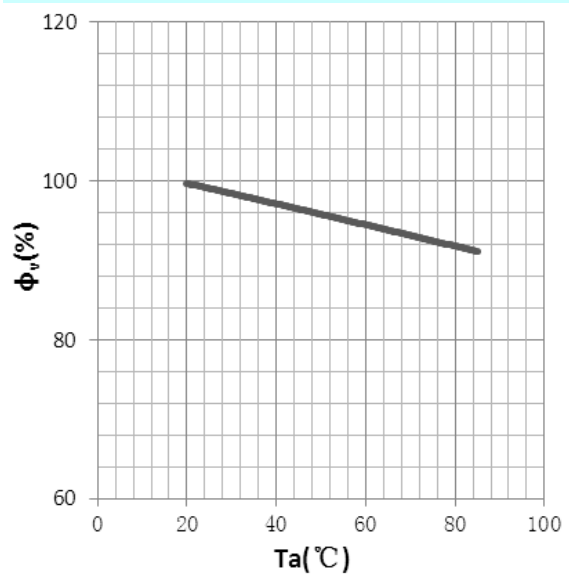
图(2) I_F-V_F 关系曲线



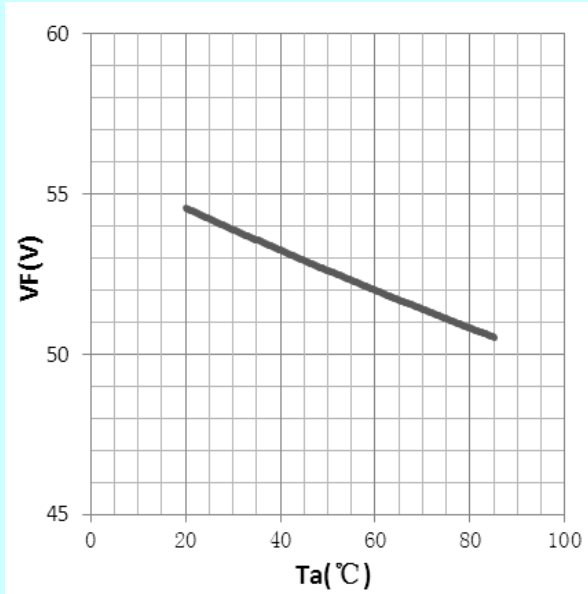
图(3) Φ_V-I_F 关系曲线



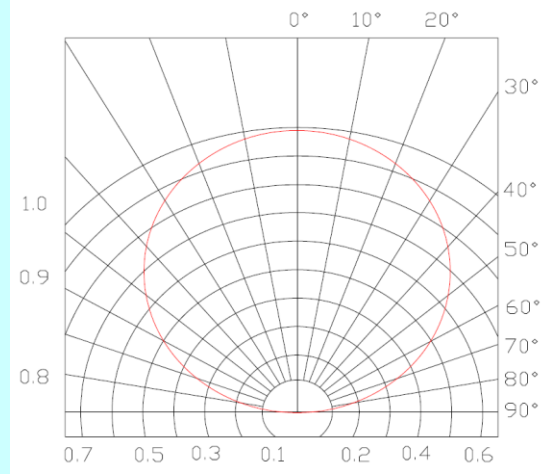
图(4) $\Phi_V(@20\text{mA}) - T_a$ 关系曲线



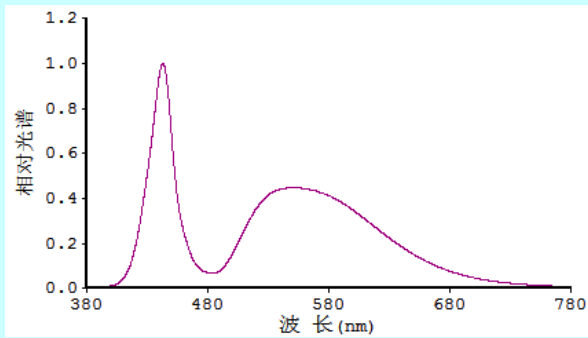
图(5) $V_F(@20mA) - T_a$ 关系曲线



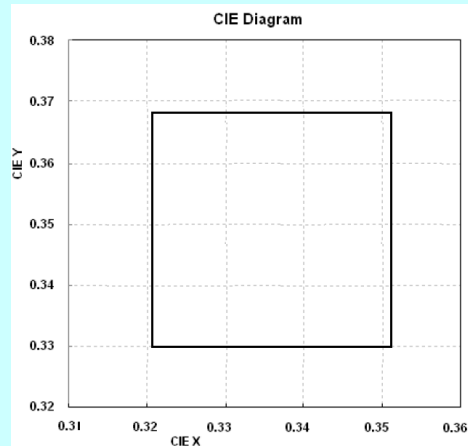
图(6) 出光角度



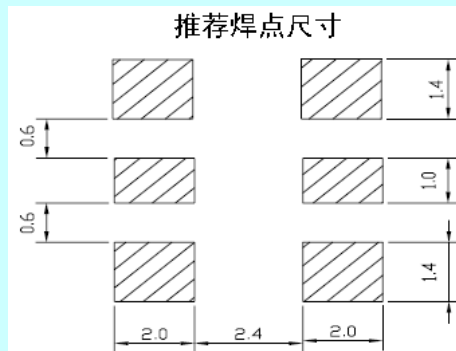
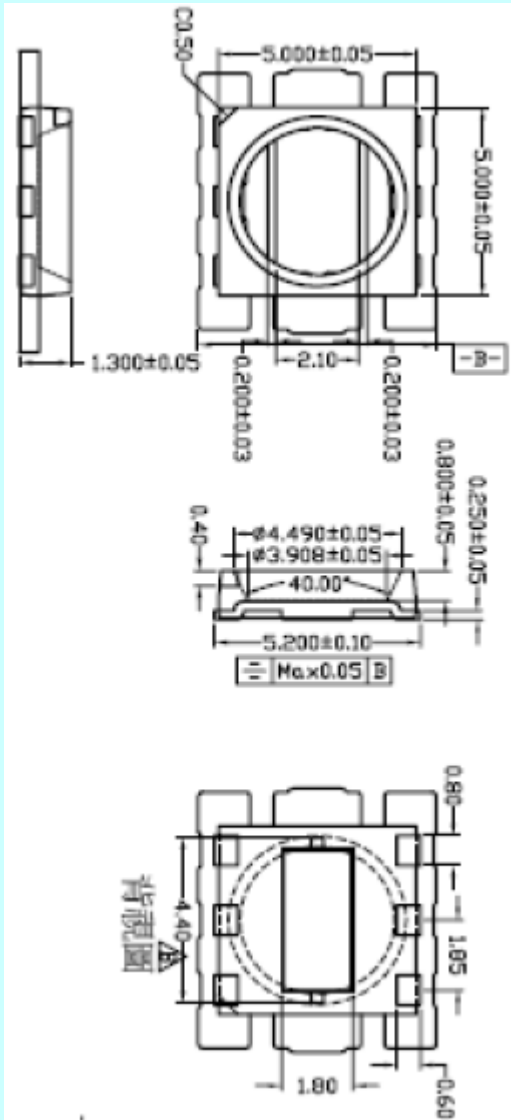
图(7) 频谱分布



图(8) 色坐标

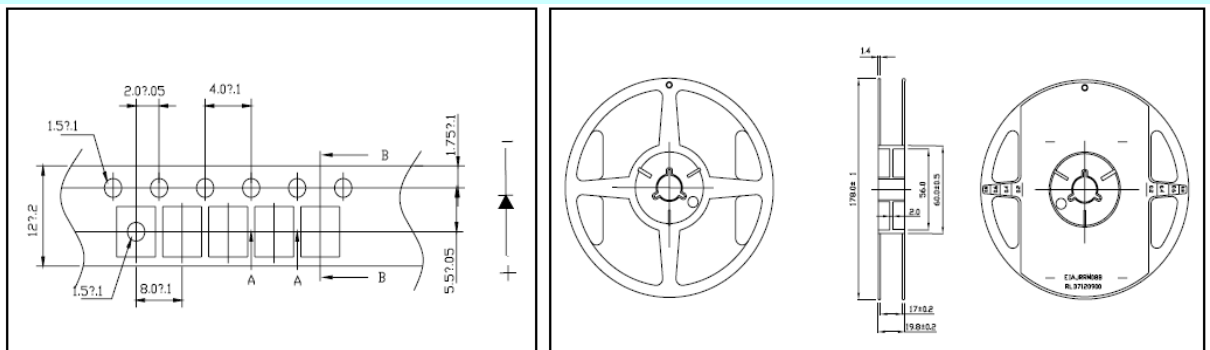


外形图 SMD5050 (单位: mm)



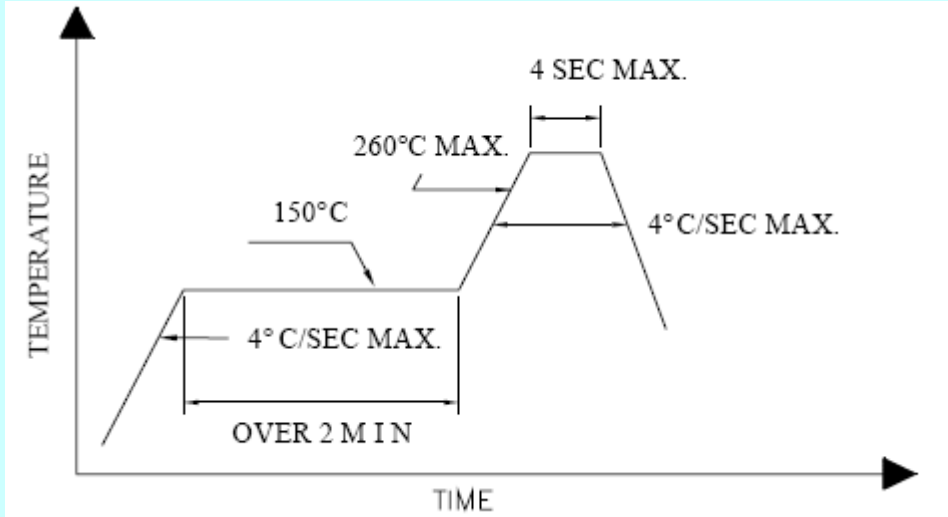
包装说明

- 1) 产品的小包装, 采用 1000 只/盘的编带包装;
- 2) 产品的中包装, 采用 10 盘/盒的纸板箱包装;
- 3) 产品的大包装, 采用 2 盒/箱的纸板箱包装。



焊接条件

1) 回流焊



2) 手工焊

烙铁温度 300°C 以下，焊接时间少于 3 秒。

注意事项

- 1) 凡华润华晶出厂的产品，均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求；对于客户有特殊要求的产品，双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用；在安装时，要注意减少机械应力的产生，防止由此引起的产品失效；避免靠近发热元件；焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) 本规格书由华润华晶公司制作，并不断更新，更新时不再专门通知。

联络方式

Marketing Part: <http://www.wimtel.com>

Tel: 0755-82389111 Fax: 0755-33065120